

피지컬 AI 반도체 글로벌 리더, 딥엑스

주요 사업 및 제품 소개



Technology

글로벌 경쟁사 대비 압도적 저전력 기술

반도체 기술의 패러다임 전환

1990년대, CPU (범용 연산의 시대)



intel

데스크탑 컴퓨터

arm
Qualcomm

모든 디바이스

VS

2020년대, GPU/NPU (Physical AI의 시대)



nvidia

AI 데이터 센터

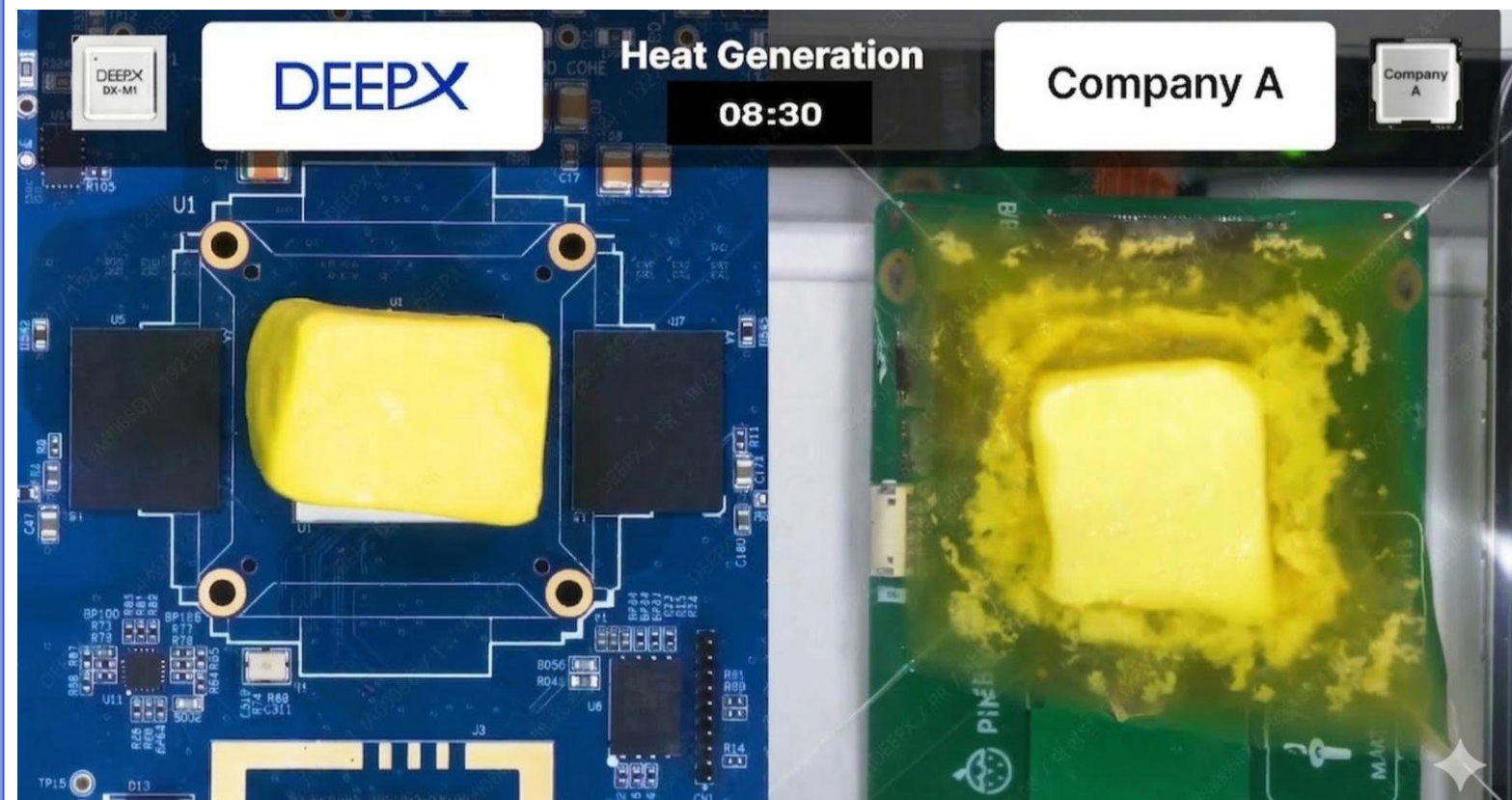


DEEPX

모든 디바이스

VS

딥엑스 1세대 제품 성능 데모 (핵심 가치 제안)



딥엑스는 글로벌 초격차 전력 효율 AI 반도체 기술 보유

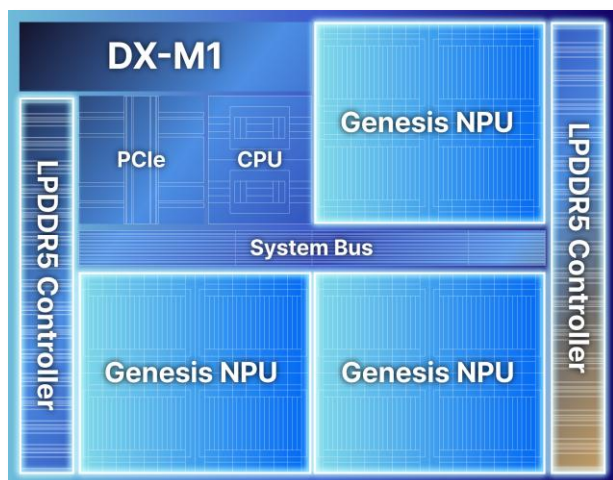
DEEPX



Cost

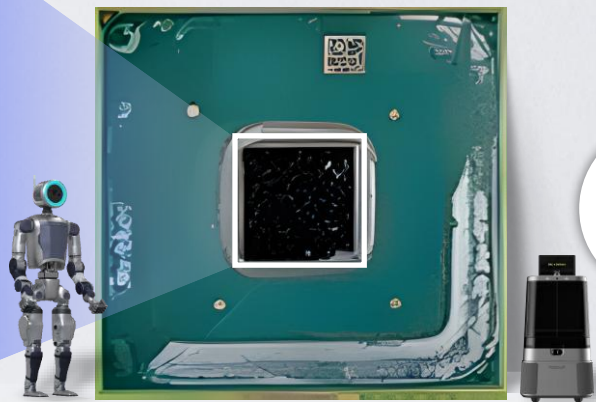
글로벌 경쟁사 대비 압도적 제조원가 확보

딥엑스 DX-M1 블록 다이어그램



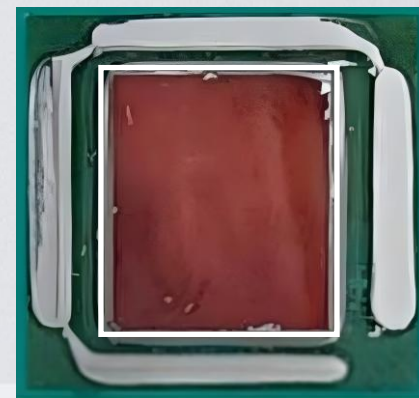
경쟁사 1:1 SRAM 사이즈 비교

DEEPIX



VS

NPU 경쟁사



딥엑스의 다이 사이즈가 경쟁사 대비 4.3배 작음. 제조원가 절감! 높은 이익 마진 가능!

반도체 치킨 게임에서도 살아남을 수 있는 압도적 제조원가 기술 보유

DEEPIX



Products

Physical AI 전방위 산업을 위한 제품군 확보

There is no Physical AI without Ultra Low Power AI Chips!

초저전력 피지컬 AI 반도체 솔루션



DX-M1

25TOPS / 5W



DX-M1M

25TOPS / 3W



DX-AIBOX

25TOPS / 5W



엣지 AI 서버 솔루션



DX-H1 V-NPU

50TOPS / 30W



DX-H1 Quattro

100TOPS / 20W

지능형 로봇



스마트 모빌리티



국방 우주항공



스마트 팩토리



반도체



스마트 조선



스마트 가전



AI 헬스케어



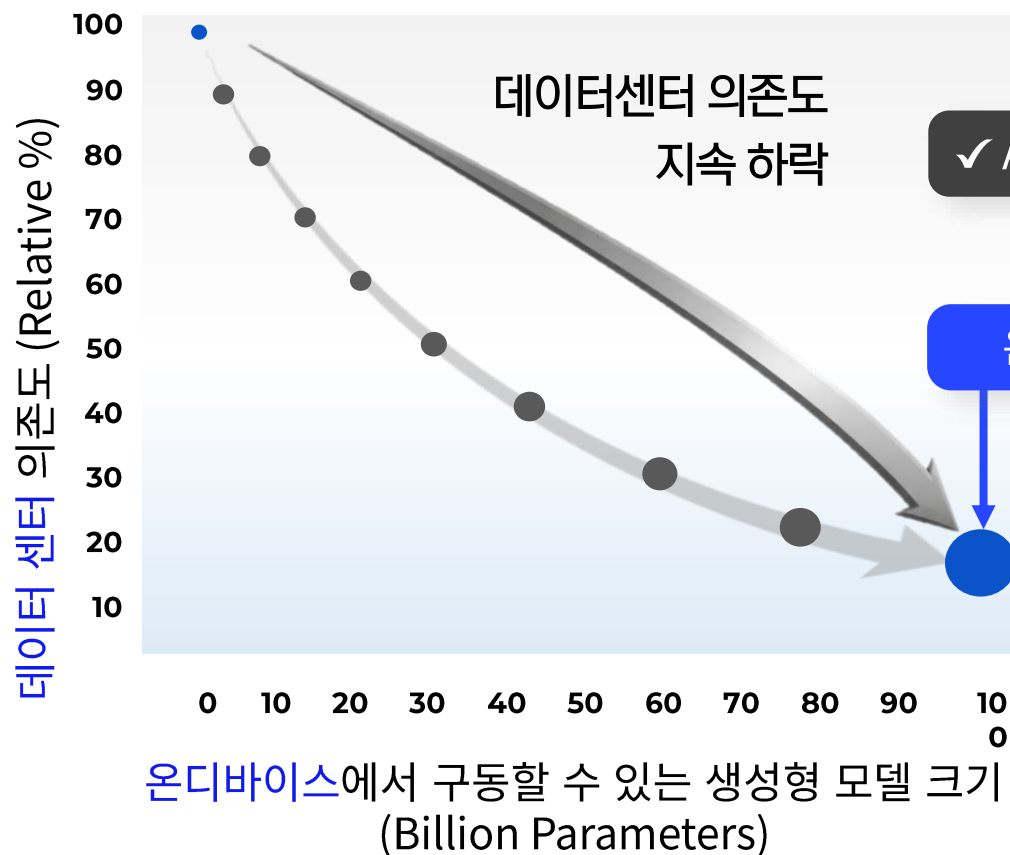
대한민국 Physical AI 주요 전략 산업 육성을 위한 핵심적 기폭제 역할

DEEPIX



Technology

데이터가 생성되는 기기에서 바로 AI 처리하여 AI 인프라를 디바이스로 내림



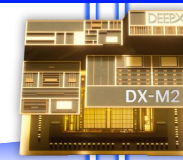
✓ AI 데이터센터 20%

온디바이스 80%

AI 데이터센터

AGI & ASI (100B)

AI 온디바이스 (Physical AI)

LLaMA
by Meta

ChatGPT

Baidu 百度

Qwen

deepseek



GPU와 비경쟁 구도의 온디바이스 AI 부문은 데이터센터 수요 분산함으로 더 큰 성장 기회 선점

DEEPX



Technology

피지컬 AI 시대의 핵심 원천 기술의 완성



✓ DEEPX Solution 2세대 생성형 AI 칩 주요 스펙

20~100B

Parameter Size

~5W

Power Consumption

20~30 TPS

Tokens Per Second

2nm

Process

80 TOPS

Tera Operation
Per SecondMemory Bandwidth
153.6 GB/s
(LPDDR5X)

최근 생성형 모델들의 경량화 트렌드

Mixture of Experts (MoE) 기술로 HW 칩의 Native 연산 능력보다 더 높은 파라미터 규모의 LLM 모델 구동 가능

	글로벌					국내				
AI Model	LLaMA by Meta	Alibaba	OpenAI	Baidu 百度	deepseek	LG AI Research	SK telecom	upstage	NAVER Cloud	NCAI
	LLaMA4 Scout	QWEN3 MoE	GPT-OSS	Ernie 4.5 MoE	DeepSeek v2 MoE	K-EXAONE	A.X K1 Light	Solar Pro 3	HGX-MoE 100B	VAETKI 100B
Parameter Active/Total	17B 109B	3.3B 30.5B	3.6B 21B	3B 21B	2.4B 16B	23B 236B	3B 20B	12B 102B	10B 100B	15B 100B

DX-M2는 데이터 센터의 생성형 AI를 심의 칩으로 각종 기기에서 온디바이스 구동하는 최적의 솔루션

DEEPX



Leadership

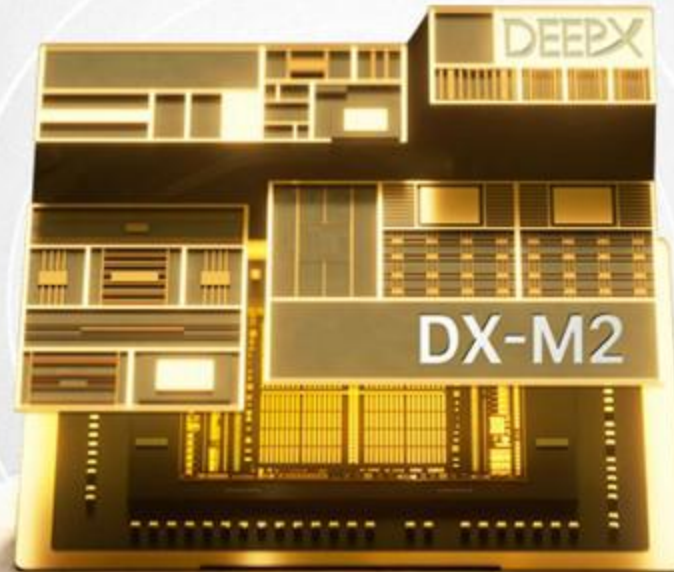
딥엑스, 피지컬 AI 글로벌 리더

HYUNDAI
MOTOR GROUP



DEEPX

Physical AI 반도체 원천 기술 글로벌 선도



Baidu 百度



첫 제품 양산 7월 만에 피지컬 AI 글로벌 플래그십 양산 확정

DEEPX



첫 제품 양산 7개월, 전세계 8개국, 7개 주요 피지컬 AI 산업, 16개 PO 획득

Smart Factory



Surveillance System



Mission Critical



Smart Mobility



AI IT Services



Smart City



글로벌 Physical AI 산업 내 상용화 성공적 수행, 전방위 확장

The End

